

Cesta De Limpieza De Ptfе Para Semiconductores Portablechas De 12 Pulgadas Para Grabado Húmedo Resistente A Ácidos Y Álcalis De Fluoropolímero

Número de artículo: PL-CP81



Introducción

Diseñada para entornos semiconductores de alta pureza, esta cesta de limpieza de obleas de PTFE de 12 pulgadas garantiza una resistencia química excepcional durante los críticos procesos de grabado húmedo y limpieza. El diseño fabricado a medida proporciona un soporte fiable para las obleas y una exposición máxima al fluido para una fabricación de precisión.

[Aprende más](#)

Aplicación	Descripción	Beneficio Clave
Limpieza RCA	Secuencia estandarizada (SC-1 y SC-2) para eliminar contaminantes orgánicos e impurezas metálicas.	Previene la recontaminación durante las transiciones de pH alto y bajo.
Grabado con HF	Eliminación de capas de óxido sacrificial u óxidos nativos utilizando soluciones de ácido fluorhídrico.	Inmunidad total al ataque del HF garantiza la supervivencia a largo plazo del equipo.
Grabado con Piranha	Mezcla a alta temperatura de ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno para la eliminación de fotorresina.	Resiste reacciones exotérmicas extremas sin ablandamiento estructural.
Enjuague Post-CMP	Eliminación de partículas de slurry y productos químicos tras el Pulido Químico Mecánico.	Los puntos de contacto mínimos evitan el atrapamiento de partículas detrás de la oblea.
Texturizado de Células Solares	Texturizado ácido o alcalino de obleas de silicio de gran formato para mejorar la absorción de luz.	Durabilidad de alto volumen en entornos de exposición química continua.
Fabricación de MEMS	Grabado húmedo profundo de sustratos de silicio o vidrio para crear estructuras micromecánicas.	Asegura tasas de grabado uniformes mediante una circulación de fluidos optimizada.
Fotolitografía	Revelado y decapado de materiales fotorresistentes utilizando disolventes orgánicos especializados.	El material resistente a disolventes evita la lixiviación de orgánicos en el revelador.
Limpieza Megasónica	Limpieza acústica de alta frecuencia para eliminar partículas submicrónicas de las superficies de las obleas.	La densidad del material transmite eficazmente la energía acústica sin efectos de amortiguación.

Característica	Detalle de Especificación (PL-CP81)
Material Principal	PTFE Virgen de Alta Pureza (Politetrafluoroetileno)
Compatibilidad con Diámetro de Oblea	300 mm (12 pulgadas) - Tamaños personalizados disponibles bajo petición
Configuración	Portablechas individual / Configuración de cesta tipo flor para múltiples obleas
Proceso de Fabricación	Mecanizado CNC de Precisión / Fabricación a Medida
Resistencia Química	Gama completa (pH 0-14); resistente a HF, HNO ₃ , HCl, H ₂ SO ₄ , KOH, etc.
Temperatura de Operación	Uso continuo hasta 260°C (Límites personalizados según diseño)

Aplicación	Descripción	Beneficio Clave
Característica	Detalle de Especificación (PL-CP81)	
Paso de Ranura / Espaciado	Totalmente personalizable para cumplir con los requisitos de flujo de fluido o capacidad	
Tipo de Contacto	Disponibles diseños de contacto por punto o por borde	
Opciones de Asa	Interfaz de brida robótica fija, removible o automatizada	
Acabado Superficial	Acabado mecanizado ultra suave para minimizar la adhesión de partículas	
Estándar de Pureza	Cumple con el grado semi; análisis de metales traza disponible	